

ความรู้พื้นฐานผู้จำลองสภาพแวดล้อม  
สำหรับงานทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

และ

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Fundamental of Simulation Environmental Chamber for

Industries Material Testing

And

Preventive Maintenance

ประยูร แสงงาม

พิชิตพล วนภูติ

17 กรกฎาคม 2556

1



**What does environmental testing mean ?**

การทดสอบ จำลองสภาพแวดล้อมหมายถึงอะไร ?

2

\* การทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต

**Biology science**

ส่วนใหญ่เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมให้

เหมาะสมในการทดสอบหรือเจริญเติบโต

+ **Plant Growth chamber**

+ **Tissue Culture chamber**

+ **Seed Germinator**

+ **Incubator >>> CO2 Incubator**

3

\* การทดลอง-ทดสอบด้านวัสดุศาสตร์

## Material science

ส่วนใหญ่เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมให้  
ไม่เหมาะสมหรือเร่งให้เกิดความเสื่อมเร็วขึ้น

- + Stability testing chamber
- + Salt Spray testing chamber
- + Thermal Shock testing chamber
- + Other chamber

4

ทำไมต้องทดสอบ ?



ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์—  
สำนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์  
โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป MP4 ฯลฯ มีการพัฒนาให้มีขนาด  
เล็กลง และมี **function** ต่างๆ ในการทำงานมากขึ้น  
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ด้านอื่นๆ เช่น ยา อาหาร เคมีภัณฑ์อื่นๆ มีโอกาสนำพา  
ใช้ในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม



5

ดังนั้นการทดสอบจำลองสภาพแวดล้อม เป็นกระบวนการหนึ่ง  
ที่มีความสำคัญ เพื่อทดสอบหาความบกพร่อง ความทนทาน  
ของสินค้า นำสู่การพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสินค้า ให้ได้ตาม  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ตลอดจนความปลอดภัยในการใช้งาน  
นำสู่ความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค



6

## What is Environmental Test

Test to analyze and evaluate effects of environmental factors such as temperature, humidity, pressure, and light on various industrial products like electronic components in order to ensure product quality.

### <During the WW II >

Environmental test was standardized in the United States for stabilizing and improving quality of military supplies.



### <Postwar >

Environmental test was JIS standardized in Japan for stabilizing and improving quality of consumer products.



### <Present >

Demand for environmental test has increased due to increased use of electronic parts, shortened development period, and pursuit for lower cost and higher quality.



1961:  
Japan's first environmental test chamber was developed.  
1971:  
Made the first presentation at The 17th IES Show (U. S. A.).  
1972:  
First-guaranteed 2-year 5000 hours in the industry.

### Japan's First Environmental Test Chamber



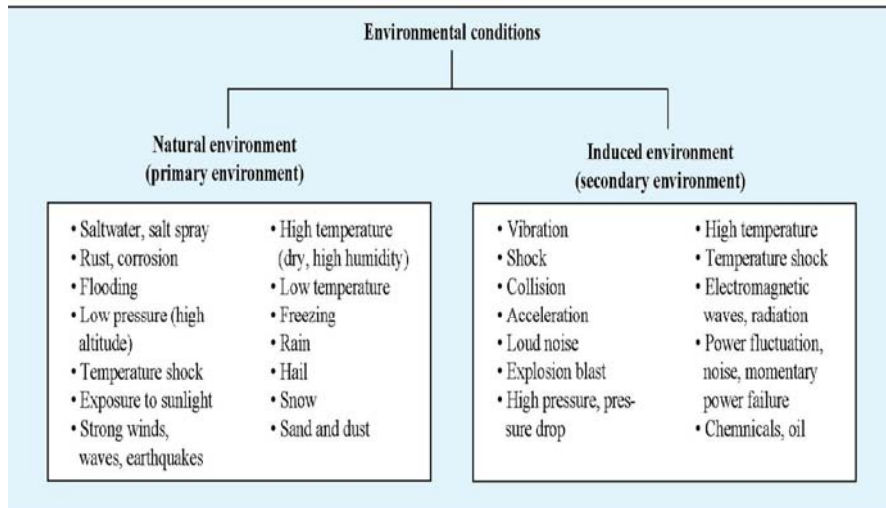
Low temperature & humidity chamber "Lucifer" (1961)

### To Global Standard



Temperature & humidity chamber "Platinous K series" (1997)

Sithiporn Associates Co.,Ltd.



Factors of environmental conditions in Combined Environmental Testing

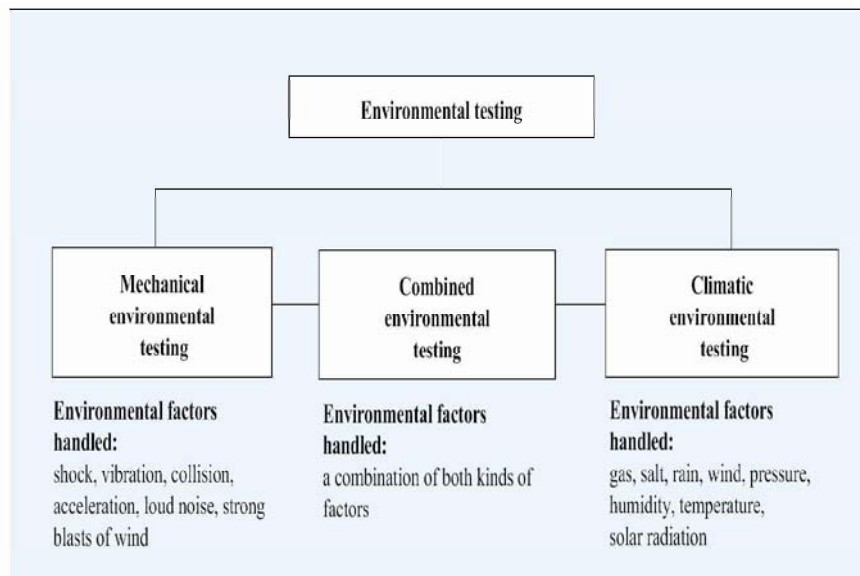


Fig 1 Types of environmental testing

ตัวอย่างเครื่องมือทดสอบด้าน **Mechanical Environmental**

ตัวอย่างเครื่องจำลอง **Vibration testing**

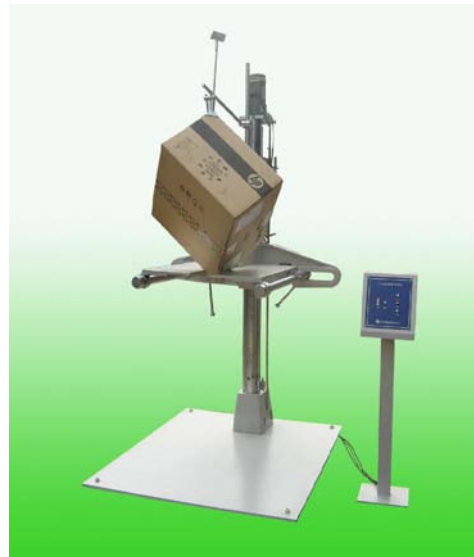


10


**Impact tester**



**DROP TESTER**




ตารางที่ 1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศ ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์

| สภาพแวดล้อม   | ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์  |
|---|--|
| <p><b>1. ลม:</b><br/>แรงปะทะของลม,<br/>ลมหมุน, พายุ</p>  | <p>ทำให้เกิดความเสื่อมสภาพ ทำลายโครงสร้างต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนภายนอกของอากาศยานซึ่งมีผิวสัมผัสปะทะกับลมและอากาศที่มีความเร็วลมแตกต่างกัน ในแต่ละด้านของผิวสัมผัส ทำให้ความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีของอากาศแตกต่างกัน มีผลให้เกิดการบิดงอของชิ้นส่วน เนื่องจากการขยายตัวของวัสดุแต่ละด้านไม่เท่ากัน</p> |

12

(ตารางที่ 1, ต่อ)

| สภาพแวดล้อม  | ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์  |
|--|--|
| 2. ความชื้น<br> | ความชื้นสามารถแทรกซึมเข้าไปในช่องว่างของสารและวัสดุต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุให้เกิด oxidation ของสารประกอบต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของชิ้นงานหรือวัสดุ เช่น วัสดุที่เป็นยางหรือปะเก็นในเครื่อง เกิดการบวม เสื่อมสภาพได้ หรือในกรณีความชื้นต่ำมาก ๆ อาจทำให้วัสดุเกิดเปราะแตกได้ง่าย |

13

ตารางที่ 1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศ ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์

| สภาพแวดล้อม   | ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์  |
|---|--|
| 2. น้ำในบรรยากาศ :<br><br><small>a. Copper migration</small> | สร้างความเสื่อมสภาพและทำลายโครงสร้างโดยที่ขึ้นส่วนต่างๆ ในขณะที่ใช้งานหากมีความร้อนสะสมอยู่ เมื่อมีน้ำหรือฝนตกถูกขึ้นส่วนเหล่านี้ ทำให้มีการลดความร้อนอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการกัดกร่อนของโครงสร้างเหล่านี้ ตลอดจนก่อให้เกิดความบกพร่องทางไฟฟ้า และทำลายพื้นผิวชิ้นงานได้ |

14

ตัวอย่างเครื่องมือทดสอบด้าน **Climatic Environmental**

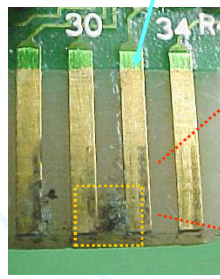
TEMPERATURE (& HUMIDITY) CHAMBER PLATINOUS J SERIES



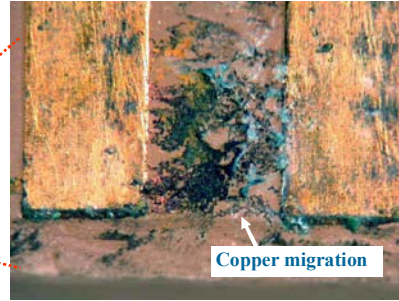
15

## Field failure : Electrochemical migration on Printed-Circuit Board

Gold plated terminal (Copper substrate)



Terminal of PCB



1mm



## Field failure : Electrochemical migration (Semiconductor package)



Rain water went into electronics equipments, and migration was occurred at lead.



## Rain & Spray Test Chambers





ตัวอย่างเครื่อง Rain Tester chamber

ESPEC has looked at the JIS specification D 0203 as a reference point, and we have also considered individual auto maker's tests. The specification from SAE is modeled after the JIS and doesn't differ greatly. Details about the nozzle types and the rotating nature of the spray arms and product table are also included in the specifications. Drip and car wash tests are also specified.

### Heavy splash/shower

- S1 Spray room temperature water with 40 nozzles at 14.2 psi (1 kgf/cm<sup>2</sup>) for 30 minutes. The flow rate of the water shall be 6.5 gallons/min. (24.5 L/m).
- S2 Spray room temperature water with 40 nozzles at 42.7 psi (3 kgf/cm<sup>2</sup>) for 60 minutes. The flow rate of the water shall be 10.3 gallons/min. (39.2 L/m).

(ตารางที่ 1, ต่อ)

| สภาพแวดล้อม   | ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์   |
|---|---|
| <p>3. ทรายนและฝุ่น</p>             | <p>ฝุ่นและทรายทำให้เกิดการขัดสีของพื้นผิว ทำให้เพิ่มแรงต้านของพื้นผิวชิ้นงาน การปนเปื้อนในน้ำมันหล่อลื่น การอุดตันของท่อ และก่อให้เกิดความผิดของกลไก การแตกหักของวัสดุต่างๆ ได้</p> |
| <p>4. ไอน้ำเกลือหรือไอน้ำทะเล</p>  | <p>เนื่องจากสารละลายเกลือต่างๆ สามารถนำไฟฟ้า ทำให้ความเป็นฉนวนลดลง และยังเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการกัดกร่อนของ electrolytic และทางเคมีแก่โลหะได้</p>                                 |

19

### Settling Dust Test Chambers

ESPEC dust chambers provide a ready-made solution to common settling dust test requirements for automotive components and electronics cabinets. Our improved W-shaped bottom provides better collection and dispersion of "Arizona fine dust" and talcum powders.

The chamber has a unique "clamshell" lid for easier front loading compared with competitive top-loading designs. Optional reach-in glove ports allow rotating the test sample without opening the door.

#### Features

- Stainless steel interior and exterior
- W-shaped bottom for improved dust collection & dispersion
- Easy-access clamshell door with viewing window and optional glove ports
- Mesh product shelf
- Two inch cable port
- Timers for agitation and settling periods

#### Applicable Test Standards

- SAE J575 Section 3.3
- DIN 40050, Part 9, IP Codes 5K and 6K
- IEC EN 60529 (IEC 529), IP Codes 5 and 6 (with optional under-pressure mode)

| Model  | Interior Volume         | Interior Dimensions                   |
|--------|-------------------------|---------------------------------------|
| EDC-27 | 27 cu. ft.<br>(750 L)   | 36" x 36" x 30"<br>(90 x 90 x 75 cm)  |
| EDC-54 | 54 cu. ft.<br>(1,500 L) | 72" x 36" x 30"<br>(180 x 90 x 75 cm) |

ตู้ทดสอบจำลองสภาพได้สภาพฝุ่น



Unique "clamshell" door for easy access


lv

### Salt Spray Testing chamber



21

(ตารางที่ 1, ต่อ)


| สภาพแวดล้อม  | ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์  |
|--|--|
| 6. แสงแดด<br> | ทำให้สีซีดจาง ในกรณีวัสดุที่เป็นยางหากถูกแสงแดดมาก ๆ ก่อให้เกิดความร้อน ส่งผลให้ยางสูญเสียความยืดหยุ่น |

22

### WALK-IN TYPE TEMPERATURE (& HUMIDITY) CHAMBER E SERIES




(ตารางที่ 1, ต่อ)

| สภาพแวดล้อม   | ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์   |
|---|---|
| 7. อุณหภูมิสูง<br> | มีผลให้การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เช่น ความต้านทาน, ความนำและความจุไฟฟ้า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำลัง, ความเป็นฉนวนไฟฟ้าถูกทำลาย ขึ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่อาจมีการขัดสีทำให้เกิดความร้อนส่งผลให้วัสดุมีการขยายตัวหรือบวมได้ นอกจากนี้ความร้อนที่เกิดขึ้นยังส่งเสริมให้เกิด oxidation และปฏิกิริยาทางเคมี หรืออาจทำให้ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นลดลงมีผลให้เครื่องจักรเกิดสึกหรอเร็วขึ้น เนื่องจากความหล่อลื่นลดลง |

24

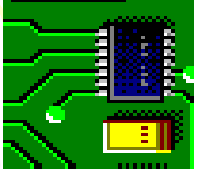


(ตารางที่ 1, ต่อ)

| สภาพแวดล้อม   | ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์  |
|---|--|
| 8. อุณหภูมิต่ำ<br> | วัสดุที่เป็นเรซินหรือยาง จะเปราะและมีความยืดหยุ่นต่ำ ทำให้เกิดน้ำแข็ง และทำให้ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นเพิ่มขึ้น มีผลให้เครื่องจักรทำงานหนักขึ้น ทำให้สูญเสียความร้อน, ทำให้พื้นผิวแตกร้าว |

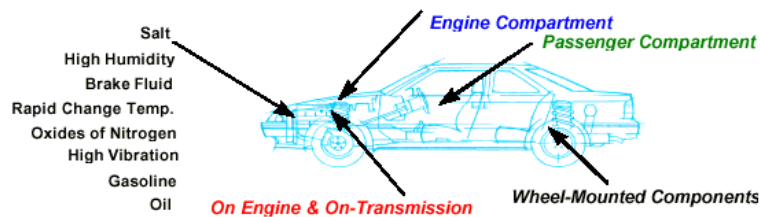
25

(ตารางที่ 1, ต่อ)

| สภาพแวดล้อม  | ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์  |
|--|--|
| 9. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน<br> | การแตกหักของวัสดุ และกลไกเกิดความบกพร่อง ทำให้ความสามารถทางไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร<br> |

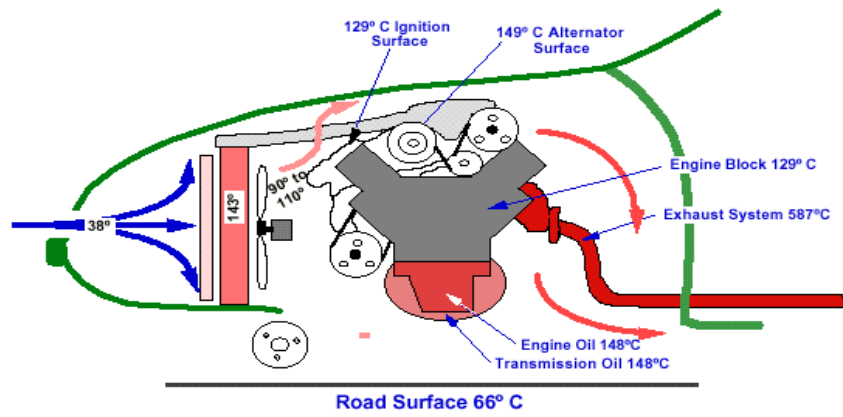
23

26



| Component Location            | Operating Temperature<br>(Baseplate) |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Passenger Compartment         | -40 °C to 85 °C                      |
| Engine Compartment            | -40 °C to 125 °C                     |
| On-Engine and On-Transmission | -40 °C to 140 °C                     |
| Wheel-Mounted Components      | -40 °C to 250 °C                     |

### Current Air Flow Dynamics



## Temperature condition requirement for automotive<sup>23</sup>

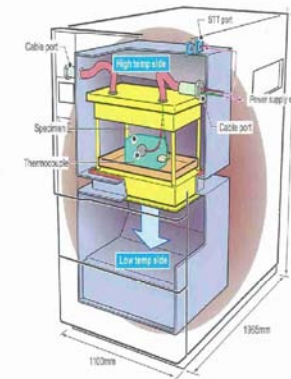
Sithiporn Associates Co.,Ltd.

### Thermal Shock Chamber

TSD-100



- Saves on Installation (Less footprint: 2.16m<sup>2</sup>)
- Only 1,100mm (43 inches) wide
- Only 1,885mm (74 inches) height
- Flush top (No protruding traveling port pipe—the port is on the side instead.)



ผู้จำลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลัน

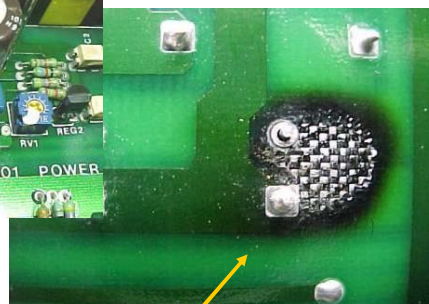
29

### Failure Example of Printed-Circuit Boards



Solder Side

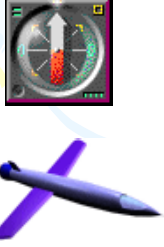
Components Side



Burnout

30

(ตารางที่ 1, ต่อ)

| สภาพแวดล้อม  | ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์   |
|--|---|
| 10. ความดันสูง -ต่ำ<br> | เป็นสาเหตุให้เกิดการแตกหัก การขยายตัว และทำลายโครงสร้างของอาคาร ภาชนะบรรจุภัณฑ์ และถังเก็บ ทำให้วัสดุปิดผนึกรั่ว ทำให้เกิดฟองอากาศภายในวัสดุ ทำให้การบดงอ ชิ้นส่วนของอากาศยาน, จรวด Missiles หรือเครื่องบิน ทำให้เกิดความผิดพลาดของเครื่องมือวัดทางการบินต่างๆ ได้ เช่น เครื่องวัดความระดับสูง ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงลักษณะทางไฟฟ้าต่างๆ |

32

## Altitude Chambers

Temperature testing at altitudes up to 100,000 feet.



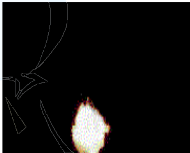
ผู้ทดสอบจำลองสภาวะ ที่ระดับความสูงต่างๆ

ESPEC can provide custom-built chambers for simultaneous testing of temperature and low-pressure altitude conditions. Two common applications are:

- Testing of avionics or other aerospace equipment to simulate actual conditions it might experience.
- Simulation of high altitude conditions like might be found in mountainous regions.
- Temperature range from -70 to 170°C
- Altitude range from ground to 100,000 feet
- Optional humidity control when altitude system is off
- Chamber interior size specified by customer
- Automatic altitude control, integrated with temperature controller —No manual setting of altitude level!
- Vacuum pump sized for climb/dive rate required by application
- Viewing window and cable ports available

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

(ตารางที่ 1, ต่อ)

| สภาพแวดล้อม  | ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์   |
|--|---|
| 11. แก๊สต่างๆ<br> | ส่งเสริมให้เกิดการกัดกร่อนของวัสดุโลหะ ความชื้นในวงจรไฟฟ้าลดลง ทำให้คุณลักษณะของ thermoelectric transfer มีการเปลี่ยนแปลง และก่อให้เกิด oxidation |

34

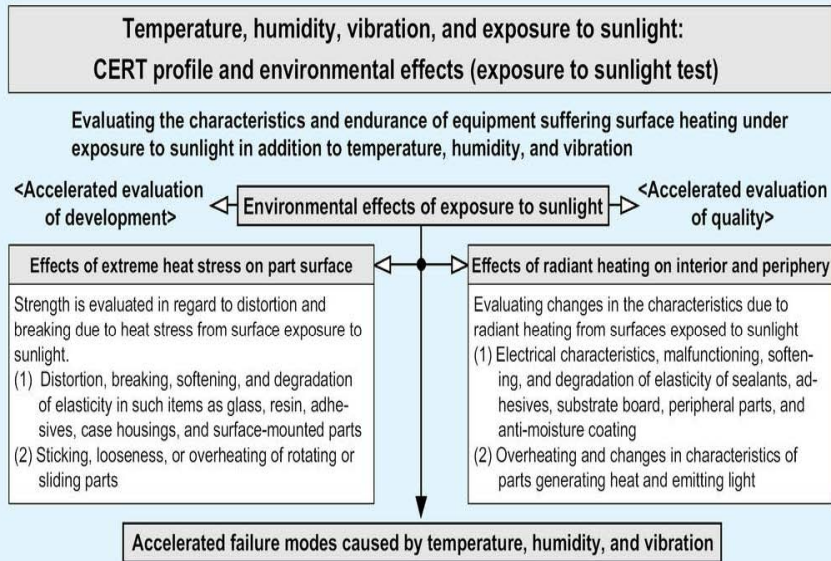
# Great Expectations for the Combined Environmental Reliability Test (CERT)

For high assembly level or finished products

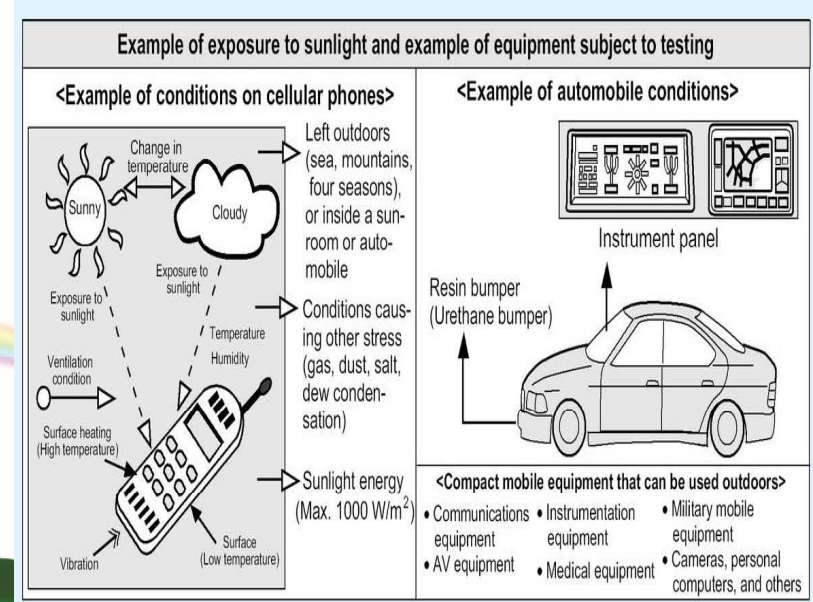
Hiramichi Fukumoto\*

*A large number of failures in the field are caused by conditions resulting from how the surrounding environment interacts with the internal characteristics of a product, creating the immense challenge of discovering this interaction as quickly and cheaply as possible. One means of doing so is the Combined Environmental Reliability Test (hereafter, CERT), based on combining accelerated factors. When using this test, both the environmental conditions for product use and product characteristics are considered in advance, and used to hypothesize the types of failure likely to occur. After first contemplating conditions unlikely to produce failure, a CERT profile is drawn up according to a reproducible mechanism for the test failure modes. In this report, I would like to present a brief explanation and introduction that can also serve as a guideline for inaugurating CERT. We shall take a close look at the correlation between failure modes and environmental stress factors and I shall discuss accelerated results, including new failure modes occurring under conditions of both combined and independent stress failure modes being used. We shall also consider application of stress failure modes to reliability testing under combined conditions that are as close as possible to the actual environment.*

Sithiporn Associates Co.,Ltd.



Sithiporn Associates Co.,Ltd.



Sithiporn Associates Co.,Ltd.

## 2-1 CERT effectiveness

The intensity of Environmental Stress Testing (hereafter, EST) and Environmental Stress Screening (hereafter, ESS) depends on such factors as the range of stress, the ratio of change, and the number of factors and cycles. Even in independent stress testing, increasing the complexity can accelerate the test 3 to 5 times. In CERT testing, 2 or more environmental factors are combined with the aim of accelerating each factor 3 to 5 times, producing an overall acceleration of tens or hundreds of times. Combining stress factors not only accelerates the failure mode for each stress factor, it also raises the possibility of introducing completely new failure modes.

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

http://www.sithiporn.com

Because of this, we have great expectations that CERT will be able to achieve important results by predicting failure modes and testing according to failure mechanisms.

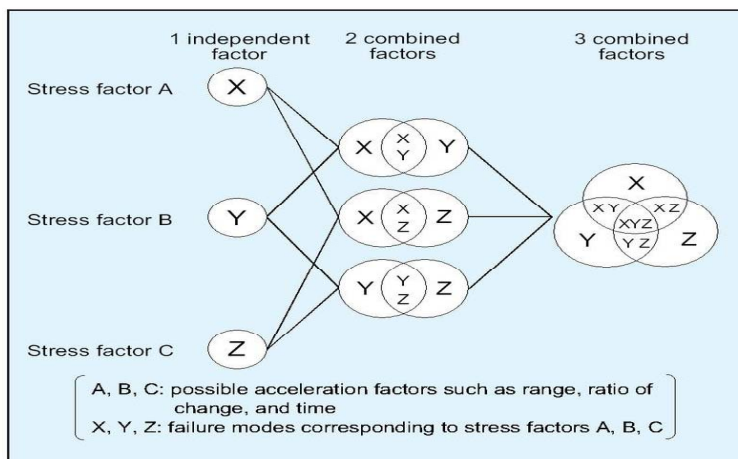


Fig. 1 Types of combined stress results

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

http://www.sithiporn.com

### (2) CERT program example

- (1) × (3), (1) × (8) — 10 cycle
- (1) × (3) × (8) — (8) Random (Refer to Fig. 2)  
 (8) Sine (at 5 to 200 Hz, 0.5G, 5 min. sweep)
- (1) × (3) × (10),  
 (1) × (10) — Fixed at product resonance frequency, 1.0G
- (7) × (1) — At constant 95% RH, temperature cycle 30°C ↔ 60°C
- (7) × (8), (9), (10) — According to purpose of the test

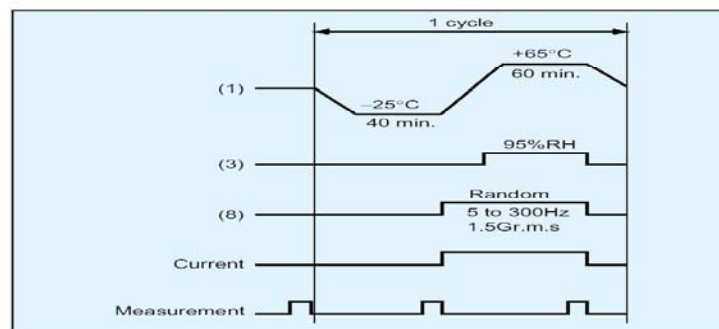


Fig. 2 Temperature-humidity-vibration CERT

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

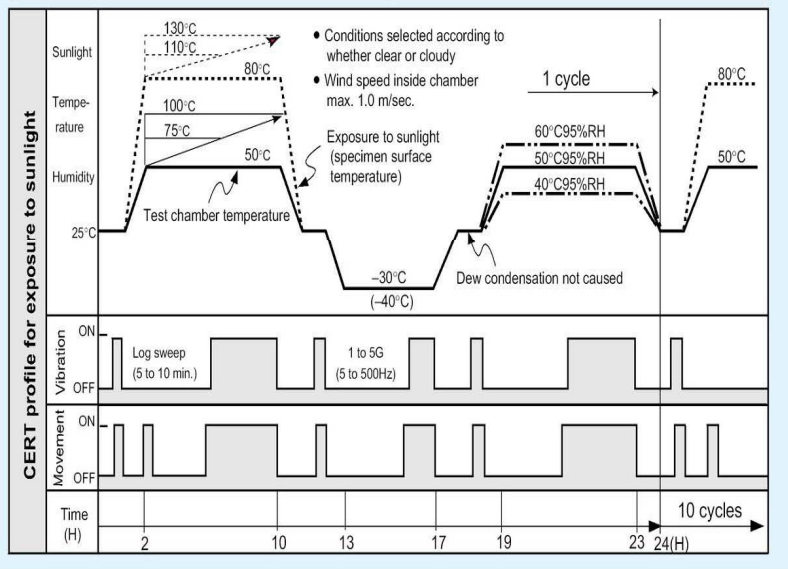


Fig. 6 Example of test conditions and effects (concrete examples of temperature, humidity, vibration, and exposure to sunlight)

Sithiporn Associates Co., Ltd.

Fig. 4 gives the TABAI ESPEC "Combined Environment Reliability Test Equipment: CERT Series" as a reference example of equipment.



Fig. 4 TABAI ESPEC's Combined Environment Reliability Test Equipment: CERT Series

Sithiporn Associates Co., Ltd.

ตัวอย่างเครื่องมือทดสอบ **Combine Environmental Testing**

**TEMPERATURE (HUMIDITY) & VIBRATION  
 COMBINED ENVIRONMENTAL TEST CHAMBER**



The environment that products encounter

At this point we will quote MIL-STD-810E, which introduces actual examples of environmental conditions encountered by products manufactured at the factory.

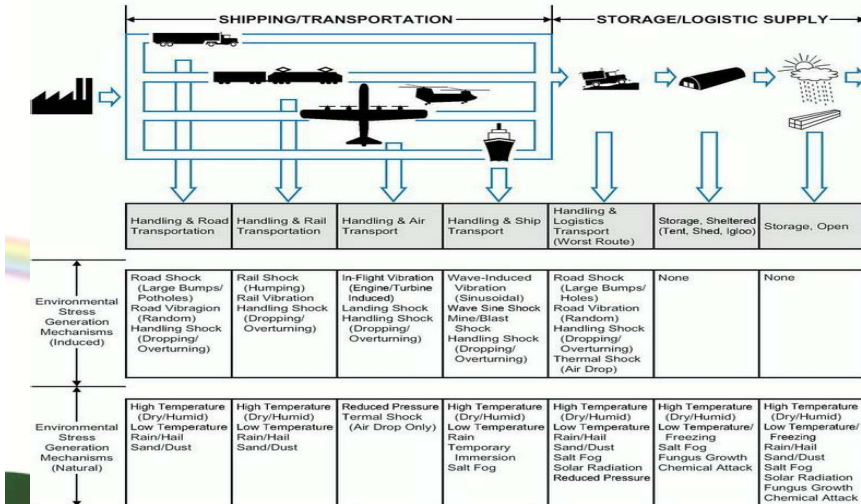


Fig. The environment that products encounter (continued)

ESPEC TECHNOLOGY REPORT NO.1

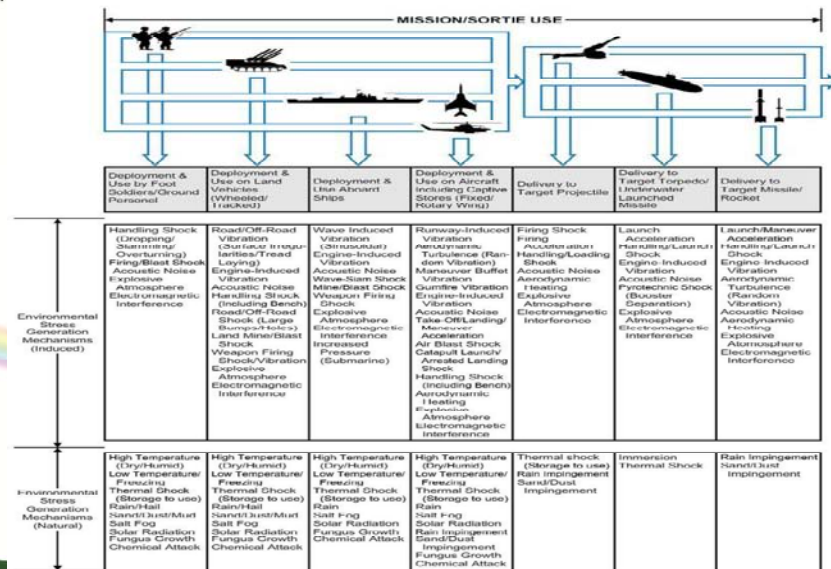


Fig. The environment that products encounter (suite)

ESPEC TECHNOLOGY REPORT NO.1

Sithiphorn Associates Co.,Ltd.

## 2.5 Standards for environmental testing

The IEC standards and MIL standards have been established as representative standards for environmental testing.

The International Electrotechnical Commission established the IEC standards for international standardization of the electrical and electronic fields. Publication 68 of the IEC standards consolidates "Basic environmental testing procedures". European countries form the core of the member nations of IEC, while the MIL (military) standards were originally established to standardize procurement of US military weapons and equipment.

## ตัวอย่าง มาตรฐานการทดสอบ IEC

Table 2 IEC Pub. 68 items on climatic environmental testing

| Standard number | Test number and item   |
|-----------------|--|
| 68-1 (1988)     | Part 1: General and guidance<br>Enumerates a series of environmental tests and appropriate severities, and prescribes various atmospheric conditions for measurements for the ability of specimens to perform under normal conditions of transportation, storage and operational use.<br>Amendment No.1 (1992)   |
| 68-2-1 (1990)   | Part 2: Tests — Tests A: Cold<br>Concerns cold tests on both non-heat-dissipating and heat-dissipating specimens.  |
| 68-2-2 (1974)   | Tests B: Dry heat<br>Contains Test Ba: Dry heat for non-heat-dissipating specimen with sudden change of temperature;<br>Test Bb: Dry heat for non-heat dissipating specimen with gradual change of temperature;<br>Test Bc: Dry heat for heat-dissipating specimen with sudden change of temperature;<br>Test Bd: Dry heat for heat-dissipating specimen with gradual change of temperature. |
| 68-2-3 (1969)   | Test Ca: Damp heat, steady state<br>Describes a continuous test at a steady temperature of 40°C and a relative humidity of 90-95%.   |
| 68-2-5 (1975)   | Test Sa: Simulated solar radiation at ground level   |
| 68-2-9 (1975)   | Guidance for solar radiation testing   |
| 68-2-10 (1988)  | Part 2: Test — Test J and guidance: Mould growth   |
| 68-2-11 (1981)  | Test Ka: Salt mist<br>Test L: Sand and dust  |
| 68-2-13 (1983)  | Test M: Low air pressure   |
| 68-2-14 (1984)  | Test N: Change of temperature  |
| 68-2-28 (1990)  | Part 2: Tests — Guidance for damp heat tests   |
| 68-2-30 (1980)  | Test Db and guidance: damp heat, cyclic (12+12-hour cycle)<br>Determines the suitability of components, equipment and other articles for use and/or storage under conditions of high humidity when combined with cyclic temperature changes.   |
| 68-2-33 (1971)  | Guidance on change of temperature tests  |
| 68-2-38 (1974)  | Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test  |
| 68-2-39 (1976)  | Test Z/AMD: Combined sequential cold, low air pressure, and damp heat test   |
| 68-2-40 (1976)  | Test Z/AM: Combined cold/low air pressure tests  |
| 68-2-41 (1976)  | Test Z/BM: Combined dry heat/low air pressure tests  |
| 68-2-42 (1982)  | Test Ke: Sulphur dioxide test for contacts and connections   |
| 68-2-43 (1976)  | Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts and connections   |
| 68-3-1 (1974)   | Part3: Background information Section One — Cold and dry heat tests  |
| 68-3-1A (1978)  | First supplement   |
| 68-3-2 (1976)   | Section Two — Combined temperature/low air pressure tests  |

MIL-STD-202 establishes testing standards for “electronic and electrical component parts”. MIL-STD-750 sets testing standards for “semiconductor devices”. MIL-STD-810 presents testing standards for “environmental test methods and engineering guidelines” (“procedure”), and MIL-STD-883 gives testing standards for “microelectronics”. Today these standards do not merely apply to procurement of military equipment, but are widely used both in the US and throughout the world as basic standards for dealing with equipment. At this point, we would like to present the organization of the IEC and MIL testing standards that are so widely employed throughout the world.

## ตัวอย่างมาตรฐานทดสอบ MIL-Standard

| MIL-STD-202F |   |
|--------------|---|
| Method No.   | Title   |
|              | <u>Environmental tests (100 class)</u>                  |
| 101D         | Salt spray (corrosion)                                  |
| 102A         | Temperature cycling<br>...Cancel effective 31 Dec. 1973 |
| 103B         | Humidity (steady state)                                 |
| 104A         | Immersion   |
| 105C         | Barometric pressure (reduced)                           |
| 106F         | Moisture resistance                                     |
| 107G         | Thermal shock   |
| 108A         | Life (at elevated ambient temperature)                  |
| 109B         | Explosion   |
| 110A         | Sand and dust   |
| 111A         | Flammability (external flame)                           |
| 112E         | Seal  |

(Physical characteristics testing omitted)



ตัวอย่างมาตรฐานทดสอบ MIL-Standard

| MIL-STD-810E |  |
|--------------|--|
| Method No.   | Title                                      |
| 500.3        | Low pressure (altitude)                    |
| 501.3        | High temperature                           |
| 502.3        | Low temperature                            |
| 503.3        | Temperature shock                          |
| 505.3        | Solar radiation (sunshine)                 |
| 506.3        | Rain                                       |
| 507.3        | Humidity                                   |
| 508.4        | Fungus                                     |
| 509.3        | Salt fog                                   |
| 510.3        | Sand and dust                              |
| 511.3        | Explosive atmosphere                       |
| 512.3        | Leakage (immersion)                        |
| 513.4        | Acceleration                               |
| 514.4        | Vibration                                  |
| 515.4        | Acoustic noise                             |
| 516.4        | Shock                                      |
| 519.4        | Gunfire                                    |
| 520.1        | Temperature, humidity, vibration, altitude |
| 521.1        | Icing/freezing rain                        |
| 523.1        | Vibro-acoustic, temperature                |

50

During world war II  
**United States Military Report**  
**High failure of some military equipment**  
**When sent electronic equipment for aircraft**  
**from USA to**  
**S/E Asia .**  
**>60 % was unusable on arrival.**  
**>After delivery 50% of spare electronic**  
**equipment stored in warehouse already**  
**failed after they were stored.**



51

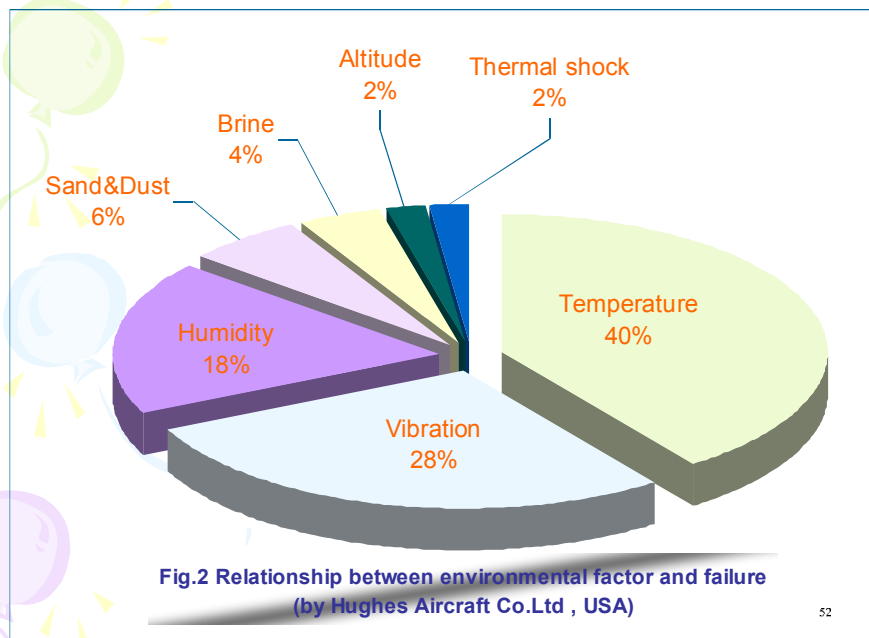


Fig.2 Relationship between environmental factor and failure (by Hughes Aircraft Co.Ltd , USA)

52

## Effect of temperature&humudity.

Products such as eletronics products or other products.

Failure cause from **Physical distortion & Chemical reaction.**

**Ex. Heat & Cold**

Difference in amount of thermal expansion between material used

to construct the product. >>Cracks occurred.>>Then product failure

Moisture penetrate through these cracks.

If product case did not crack.>>> Moisture penetrate through surface of material

Then chemical reaction occurred,>>> Product failure\*\*



53

## แนวทางทดสอบความคงสภาพของยา และผลิตภัณฑ์ยา

ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการบำบัดรักษา ตั้งแต่แรกผลิตจนถึงมือผู้ใช้ แต่การที่ผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ ถูกเก็บรักษาในสภาวะที่ไม่เหมาะสมและผ่านระบบการกระจายผลิตภัณฑ์ยา (Distribution chain) ในสภาวะภูมิอากาศต่างๆ สามารถส่งผลให้เกิดการเสื่อมสลายทั้งทางฟิสิกส์และทางเคมี ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาลดลง และอาจเกิดสารเสื่อมสลายที่เป็นพิษต่อร่างกาย ปัญหาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาจึงมีความสำคัญ และถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ผลิตยาในการดำเนินการศึกษาความคงสภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

## ICH GUIDELINES STABILITY TESTING OF NEW DRUG SUBSTANCES AND DRUG PRODUCTS

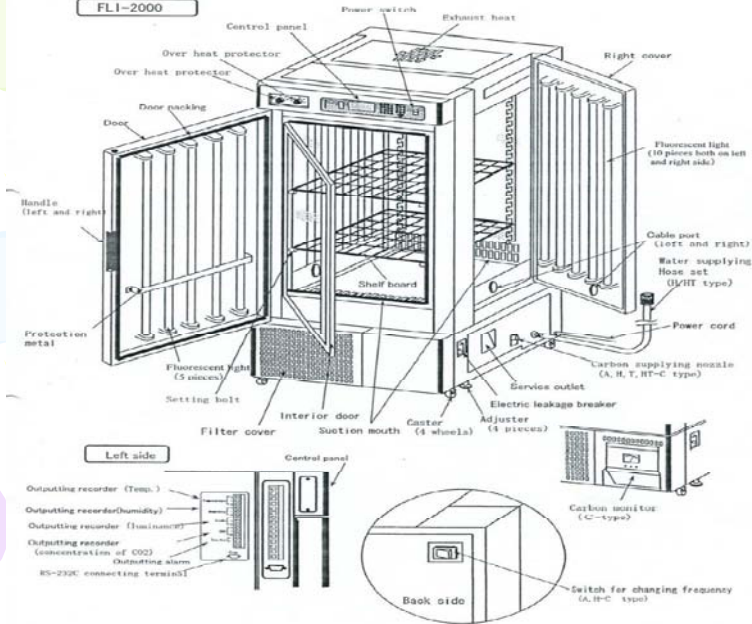
| Type  | Study  | Storage Condition           |                              | Min. Time |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   |  | Temperature                 | Humidity                     |           |
| General Case  | Long Term  | 25°C ± 2°C or<br>30°C ± 2°C | 60%RH ± 5%RH<br>65%RH ± 5%RH | 12 months |
|   | Intermediate   | 30°C ± 2°C                  | 65%RH ± 5%RH                 | 6 months  |
|   | Accelerated  | 40°C ± 2°C                  | 75%RH ± 5%RH                 | 6 months  |
| Intended for Storage in a Refrigerator              | Long Term  | 5°C ± 3°C                   | —                            | 12 months |
|   | Accelerated  | 25°C ± 2°C                  | 60%RH ± 5%RH                 | 6 months  |
| Intended for Storage in a Freezer                   | Long Term  | -20°C ± 5°C                 | —                            | 12 months |
| Aqueous-Based Products in Semi-Permeable containers | Long Term  | 25°C ± 2°C or<br>30°C ± 2°C | 40%RH ± 5%RH<br>35%RH ± 5%RH | 12 months |
|   | Intermediate   | 30°C ± 2°C                  | 65%RH ± 5%RH                 | 6 months  |
|   | Accelerated  | 40°C ± 2°C                  | Not more than 25%RH          | 6 months  |
| Photo stability Testing                             | Light exposure providing an overall illumination of not less than 1,200,000 Lux hours and an integrated near-UVA energy of not less than 200 watt hours/m <sup>2</sup> |                             |                              |           |

**ICH**-International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use.

The purpose of stability testing is to provide evidence on how the quality of a drug substance or drug product varies with time under the influence of a variety of environmental factors such as temperature, humidity, and light, and to establish a re-test period for the drug substance or a shelf life for the drug product and recommended storage conditions.

2-5 Name of each part

FLI-2000



4.5 สภาวะการทดสอบในการยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับยาในชั้นแรกอย่างน้อยต้องมีผลการทดสอบ

ทั้ง Long Term Testing และ Accelerated Testing ควบคู่กัน

| ชนิดการทดสอบ         | สภาวะการทดสอบ                    | ช่วงเวลาการทดสอบเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยา |
|----------------------|----------------------------------|--|
| Long Term Testing    | 30°C ± 2°C / 75% RH ± 5% RH หรือ | 6 เดือน (ก)                                |
|                      | 25°C ± 2°C / 60% RH ± 5% RH      | 12 เดือน (ข)                               |
| Accelerated Testing* | 40°C ± 2°C / 75% RH ± 5% RH      | 6 เดือน                                    |
|                      | 45°C ± 2°C / 75% RH ± 5% RH      | 4 เดือน                                    |
|                      | 45-50°C ± 2°C / 75% RH ± 5% RH   | 3 เดือน                                    |

หมายเหตุ: ประเภท ก. หมายถึง ยารูปแบบทั่วไป

ประเภท ข. หมายถึง ยาใหม่ หรือ ยารูปแบบพิเศษ

\* บางกรณีที่ยาประเภท ก. ไม่สามารถทดสอบสภาวะเร่ง เช่น ยาครีม แคปซูลชนิดนิ่ม ช่วงเวลาการทดสอบแบบระยะยาวต้องเพิ่มเป็น 12 เดือน

แนวทางการทดสอบความคงสภาพของยา และผลิตภัณฑ์ยา

ข้อมูลสำคัญจากผลการทดสอบในสภาวะเร่งที่แสดงถึงความไม่คงสภาพของผลิตภัณฑ์ยา คือ  
คุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิต ได้แก่

- ปริมาณตัวยาสำคัญหรือ potency ลดลงมากกว่า 5% จากจุดเริ่มต้นการทดสอบ
- ปริมาณสารเสื่อมสลายเกินค่าที่กำหนดไว้
- ลักษณะทางฟิสิกส์อื่น ๆ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เช่น ลักษณะภายนอก สี การแยกชั้น resuspendability, delivery per actuation, caking, hardness
- ค่า pH เกินช่วงที่กำหนด
- การละลายของตัวยา 12 เม็ดแคปซูล ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

กรณีพบว่าผลิตภัณฑ์ยาไม่คงสภาพเมื่อทดสอบในสภาวะ 30°C ± 2°C / 75% RH ± 5% RH ตามช่วงเวลาที่กำหนด ผู้ทดสอบอาจแก้ไขได้โดย (1) ลดอายุการใช้ (2) เปลี่ยนภาชนะบรรจุเป็นชนิดที่ป้องกันความชื้นเพิ่มขึ้น (3) แจ้งข้อควรระวังในการเก็บยาในฉลาก ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากข้อมูลการทดสอบเพิ่มเติม

## ยาที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ

\*ถ้าพบการสูญเสียน้ำเกิน 5% จากจุดเริ่มต้นในการทดสอบที่  $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  ความชื้น

ไม่เกิน 25% RH นาน 3 เดือน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะชนิด semi-permeable ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น้อยสำคัญ ส่วนผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก เช่น 1 ml หรือน้อยกว่านั้นหรือ unit dose product ต้องแล้วแต่พิจารณา

59

การที่อาหารที่เก็บมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพจนถึงจุดที่เรา  
ไม่ต้องการ (undersirable state) เนื่องจากการ  
เปลี่ยนแปลงที่ทำให้อาหารเกิดการเสื่อมเสีย ซึ่งได้แก่

- ◆ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
- ◆ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
- ◆ การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจุลินทรีย์

## The role of temperature in reaction rate

In 1889, the Swedish Physicist "S.T. Arrhenius discovered the Linear relationship between the rate constant (K) and temperature (T)

$$\log K \propto 1/T$$

T = Absolute temperature =  $273 + t^{\circ}\text{C}$

In general, the higher temperature the faster reaction.

If temperature rises  $10^{\circ}\text{C}$  the rate constant becomes 2 to 3 times greater, so expressions as the  $10^{\circ}\text{C}$  rule are used.

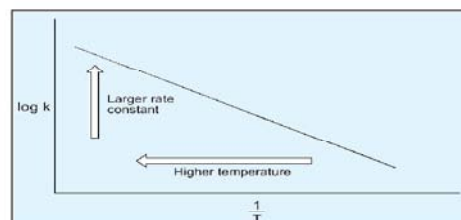


Fig. The relationship between the rate constant and temperature



## Temperature-related accelerated testing

When discussing the life of manufactured goods generally, the expression “0°C rule” can be used. This expression can be used as in the “10°C rule” to mean that a 10°C rise in the ambient temperature cuts life in half, a 20°C rise in ambient temperature cuts life in one quarter, etc. This rule indicates how strongly temperature influences life (failure).

62

The Arrhenius model is widely used for acceleration of temperature-related stress. In the Arrhenius model, life and the inverse number of absolute temperature are always shown as straight lines on the semilog graph.

63

For acceleration factor  $K$ ,

$$K = \frac{L_1}{L_2} = \frac{\exp\left(\frac{Ea}{RT_0}\right)}{\exp\left(\frac{Ea}{RT_a}\right)} = \exp\left\{\frac{Ea}{R}\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T_a}\right)\right\}$$

$K$ : Constant

$Ea$ : Activation energy (eV)

$R$ : Boltzmann's constant  $8.6159 \times 10^{-5}$  (eV/°K)

$T$ : Absolute temperature (°K)

$= 273.15 + \text{Celsius temperature } t^{\circ}\text{C}$

$t$ : Celsius temperature (°C)

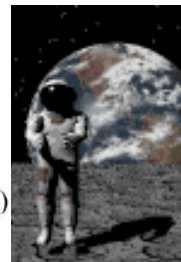
$T_0$ : Criteria temperature (°K)

$T_a$ : Test temperature (°K)

$L_1$ : Life (h) at test temperature  $T_a$  (°K)

$L_2$ : Life (h) at criteria temperature  $T_0$  (°K)

Given that  $T_a > T_0$ .



## Activation state and activation energy

When dealing with the problems of failure analysis and life of electrical and electronic parts, attention repeatedly focuses on activation energy. This is because the degradation of part functions is deeply related to the manner in which the chemical reaction proceeds.

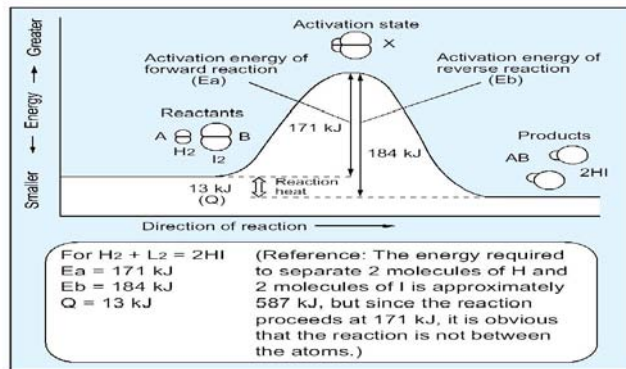


Fig. Activation energy

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

Table 5 Semiconductor device failure mechanism and activation energy

| Device name     | Failure type                   | Failure mechanism  | Activation energy (eV) |
|-----------------|--------------------------------|--|------------------------|
| IC              | Disconnection                  | Compound forms between the metals Au-Al                    | 1.0                    |
| IC              | Disconnection                  | Electromigration of Al                                     | 0.6                    |
| IC (plastic)    | Disconnection                  | Al corrosion   | 0.56                   |
| MOS IC (memory) | Short circuit                  | Destruction of oxide film                                  | 0.3 - 0.35             |
| Diode           | Short circuit                  | Destruction of PN junction (solid phase reaction of Au-Si) | 1.5                    |
| Transistor      | Short circuit                  | Electromigration of Au                                     | 0.6                    |
| MOS device      | Variation in threshold voltage | Polarization of phosphorescent glass                       | 1.0                    |
| MOS device      | Variation in threshold voltage | Na ion drift in Si oxide film                              | 1.2 - 1.4              |
| MOS device      | Variation in threshold voltage | Slow trapping of Si-Si oxide film surface                  | 1.0                    |

From the "Mitsubishi Semiconductor Reliability Handbook" (1985) of Mitsubishi Electric Corporation

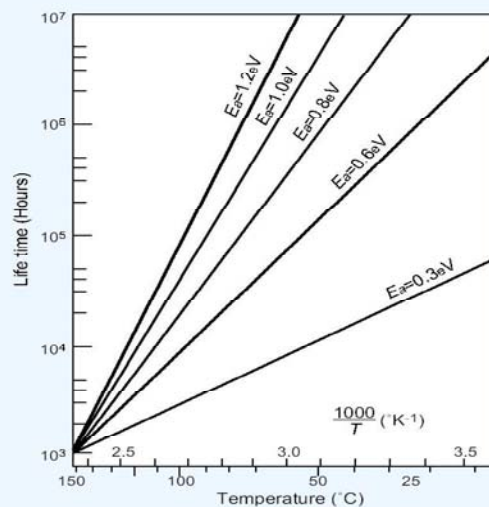


Fig. Relationship between temperature and life

From the "Semiconductor Device Reliability Handbook" (1988) of Matsushita Electronics Corporation

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

## Accelerate testing of temperature and humidity



Why accelerate testing ?

To shorten testing time.

To endure the product for reliability by testing more severe than the standard testing condition.



Sithiporn Associates Co.,Ltd.

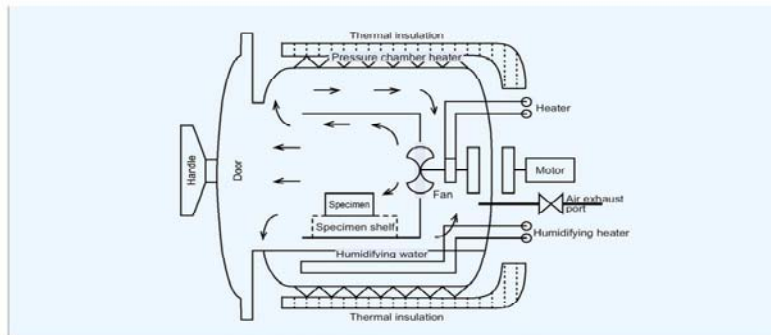


Fig.2 TABAI ESPEC's Unsaturated Pressure Cooker

Table 3 A comparison of the Pressure Cooker and the Unsaturated Pressure Cooker

| Pressure Cooker  | Unsaturated Pressure Cooker   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Test chamber simple and economical</li> <li>• Strong effects of dew condensation</li> <li>• Poor correlation to failure modes in the field</li> <li>• Poor test reproducibility</li> <li>• Difficult to apply bias</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Test chamber complicated and expensive</li> <li>• Good correlation to failure modes in the field</li> <li>• Good test reproducibility</li> <li>• Easy to apply bias</li> </ul> |

Kiyoshi Takahisa/Shigeharu Yamamoto/Yoshihumi Shibata/Terumori Sasaki/Hideo Iwama:  
From the "Reliability Test of Device and Components" (1992) Union of Japanese Scientists and Engineers

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

## The relationship between accelerated testing and predicting product life.

From the standpoint of environmental conditions, we shall set the following theme. "What levels of acceleration are possible if instead of using a TH (Temperature and Humidity) test with test conditions of 85°C and 85 percent RH, we substitute a HAST (Highly Accelerated Temperature and Humidity Stress Test) with test conditions of 120 to 140°C and 85 percent RH? Also, using those results, to what level of reliability can we predict product life in the field?"

$$Ac = \frac{L_2}{L_1} = \exp \left[ \frac{E}{R} \left( \frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \right]$$

If we say that  $R = 8.615 \times 10^{-5}$  (eV/K), the above formula becomes the following.

$$E/R = E/8.615 \times 10^{-5} = E \times 10^5 / 8.615 = 1.16 \times 10^4 \times E$$

$$Ac = \exp \left\{ 1.16 \times 10^4 \times E \times \left( \frac{1}{273 + T_{85}} - \frac{1}{273 + T_{HAST}} \right) \right\} \quad (3.11)$$



71

**Table Acceleration factors for TH tests in HAST**

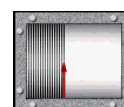
| E (eV) |              | 0.6  | <u>0.8</u>  | 1.0  | 1.2  | 1.5  |
|--------|--------------|------|-------------|------|------|------|
| HAST   | 110°C        | 3.56 | 5.43        | 8.29 | 12.7 | 23.9 |
|        | 120°C        | 5.65 | 10.1        | 17.9 | 31.9 | 75.8 |
|        | <u>130°C</u> | 8.77 | <u>18.1</u> | 37.3 | 76.6 | 228  |
|        | 140°C        | 13.3 | 31.6        | 74.8 | 177  | 647  |

Note: The values of  $E$ , the activation energy, are values obtained from typical failure modes of semiconductor devices, but please regard these numerical values as strictly hypothetical.

72

Next, from the results of HAST (130°C and 85 percent RH), let's try to predict the corresponding product life for a product submitted to the test, and let's say that the product will be used in Japan in a typical Japanese summer environment of 35°C and 85 percent RH. Let's take the lower limit for the value of  $E$  as 0.8 and the upper limit as 1.0.

Predicted life when  $E = 0.8$



73



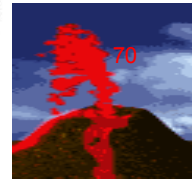
$$L_{E=0.8} = \exp \left\{ 1.16 \times 10^4 \times 0.8 \times \left( \frac{1}{273 + 35} - \frac{1}{273 + 130} \right) \right\}$$

$$= 1268.512 \longrightarrow \text{approximately } \underline{1200 \text{ times}}$$

Predicted life when  $E = 1.0$

$$L_{E=1.0} = \exp \left\{ 1.16 \times 10^4 \times 1.0 \times \left( \frac{1}{273 + 35} - \frac{1}{273 + 130} \right) \right\}$$

$$= 7570.39 \longrightarrow \text{approximately } \underline{7500 \text{ times}}$$



Therefore, if we perform a 48-hour test using the above test conditions, and we say that failure did not occur, the product life in the field would be:

For  $E = 0.8$ :  $48 \times 1200 = 57,600$  hours = 6.5 equivalent years

For  $E = 1.0$ :  $48 \times 7500 = 360,000$  hours = 41.0 equivalent years



75

There are three variables ( $E$ ,  $T_1$ , and  $T_2$ ) in formula (3.10), given earlier for finding the extremely simple acceleration factor. We have nothing to say at this point about  $T_1$  and  $T_2$ , but  $E$  is crucial. It is the value for activation energy, and as we saw in the previous example, even a slight change in this value can yield a prediction for product life that is about six times longer. Therefore, the actual value of  $E$  must be found at all costs from the experimental data itself.

Well, how should we go about finding the value of  $E$ ?

76

## Question

Preliminary testing of a certain product found that the MTTF (mean time to failure) was 310 hours at 150°C, 1000 hours at 125°C, and 4000 hours at 100°C. Let's hypothesize that the failure mechanism for this product does not change at temperatures between 75 and 150°C, and answer the following questions.

- (1) Find the activation energy, then find the MTTF at 75°C.
- (2) Indicate whether a test should be run to find how many hours MTTF will be at 125°C to prove that MTTF is 5000 hours at 75°C.

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

## Answers

(1)

- a) First of all, arrange the preconditions as follows.

$L_{150} = 310$ -hour life at 150°C

$L_{125} = 1000$ -hour life at 125°C

$L_{100} = 4000$ -hour life at 100°C

- b) Next, using the second of the two formulas in (3.10), change the formula to find  $E$ .

$$\ln \frac{L_2}{L_1} = \left[ \frac{E}{R} \left( \frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \right]$$
$$\rightarrow E = \frac{R(\ln L_{100} / L_{150})}{\left[ \frac{1}{T_{100}} - \frac{1}{T_{150}} \right]} \quad (3.11)$$

78

If we substitute the actual values in formula (3.11), we get

$$E = \frac{8.615 \times 10^{-5} (\ln 4000 / 310)}{\frac{1}{273 + 100} - \frac{1}{273 + 150}}$$
$$= 0.68(\text{eV}) \dots \text{the activation energy}$$

79

c) Since we have found the activation energy, let's see what sort of ratio exists between  $L_{100}$  ( $T = 100^\circ\text{C}$ ) and  $L_{75}$  ( $T = 75^\circ\text{C}$ ).

$$\ln \frac{L_{75}}{L_{100}} = \frac{0.68}{8.615 \times 10^{-5}} \left( \frac{1}{273 + 75} - \frac{1}{273 + 100} \right)$$
$$= 1.523$$

$\therefore L_{75}/L_{100} = \exp 1.523 = 4.59$  (the acceleration level between  $L_{75}$  and  $L_{100}$ )

Since the MTTF is 4000 hours when  $T = 100^\circ\text{C}$ , we can find the MTTF when  $T = 75^\circ\text{C}$  by calculating  $4000(\text{hr}) \times 4.59 = 18,360(\text{hr})$ .

(2)

Using the MTTF for  $T = 75^\circ\text{C}$  found above in part (1), find the acceleration factor between  $L_{75}$  and  $L_{125}$ .

$$\underline{Ac = L_{75}/L_{125} = 18,360\text{hr}/1,000\text{hr} = 18.36}$$

Therefore, to prove that MTTF is 5000 hours at temperature conditions of  $75^\circ\text{C}$ , the conditions at  $125^\circ\text{C}$  would be  $5000(\text{hr})/18.36 = 272.33(\text{hr})$ . In other words, a test of approximately 272 hours would be required.

81

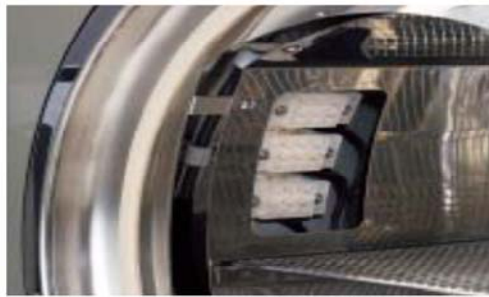
#### ■ Evaluation of ion migration



Example of the Highly accelerated stress test system with the Ion migration evaluation system



Specimen signal terminals



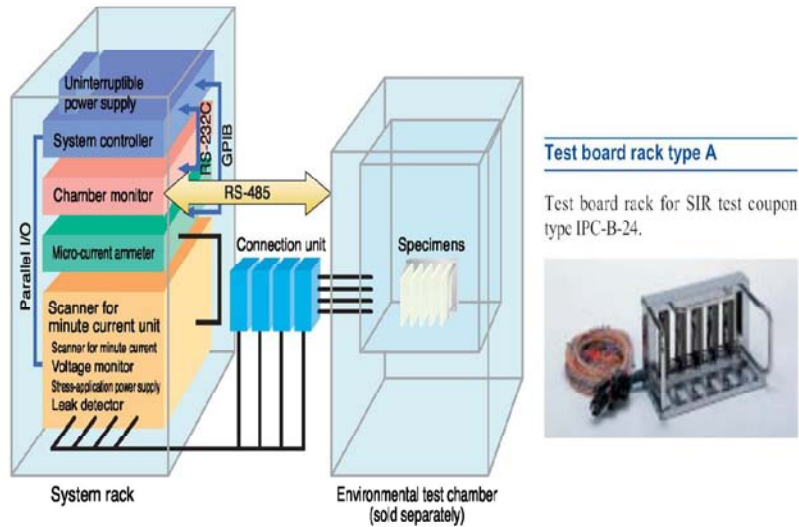
Signal terminals inside chamber



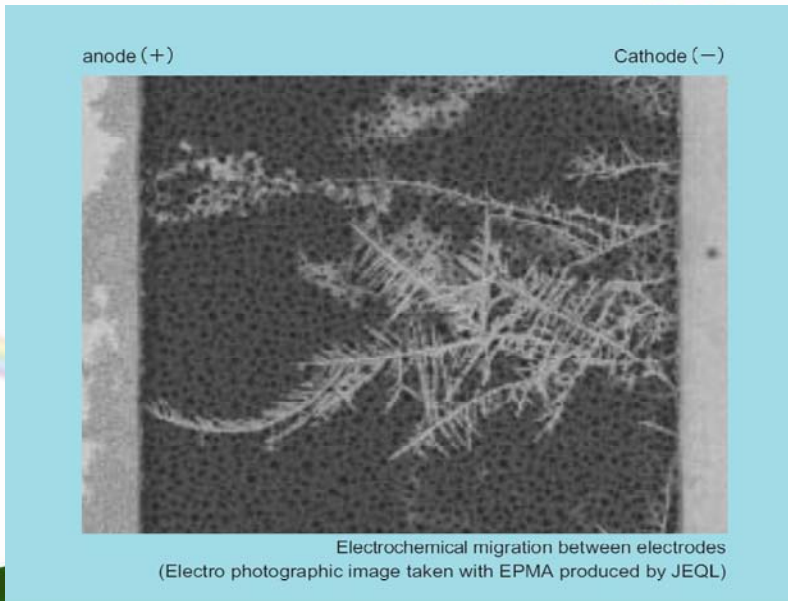
Customized sliding rack (example)

3

### SYSTEM CONFIGURATION DIAGRAM



Sithiporn Associates Co.,Ltd.

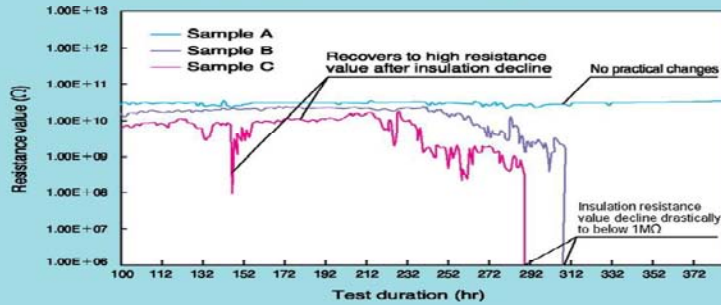


Sithiporn Associates Co.,Ltd.

**● Example of results obtained from the Ion Migration Evaluation System (AMI)**

Insulation resistance variation characteristics of flux under high-temperature and high-humidity conditions

Test conditions  
 Temperature and humidity condition : 40°C, 90%rh  
 Stress voltage : 50 V DC  
 Measurement voltage : 50 V DC  
 Measurement intervals : 0.5h



In the example above, the Leak Touch occurs at 291.2 hours and at 311.8 hours after the measurement starts.

\*The above test results were obtained from the Ion Migration Evaluation System, and processed under an excel format (spreadsheet software).

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

สามารถหาค่า Ea ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ Thermal Analysis เช่น

**-Differential Scanning Calorimeter (DSC)**

วิเคราะห์หาปริมาณพลังงานความร้อน (Enthalpy) อุณหภูมิ Glass transition อุณหภูมิ / เวลา / เปอร์เซ็นต์การเกิดผลึก อุณหภูมิการหลอมเหลว อัตรา/ระดับการเกิดโชนเชื่อมโชนโมเลกุล (Rate / Degree of Cure) ความร้อนจำเพาะ (Heat capacity)

- สามารถโปรแกรมอุณหภูมิได้ตั้งแต่จุดหลอมถึง 725 C
- -90 ถึง 550 C เมื่อใช้งานร่วมกับระบบทำความเย็นเชิงกล
- -180 ถึง 550 C เมื่อใช้งานร่วมกับระบบไนโตรเจนเหลว

ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อแผนกขาย APD-S

คุณบุญศรี - คุณศมนวรรณ



87

ตัวอย่าง การศึกษาความร้อนที่เกิดใน PCBA เมื่อมีการใช้งานจริง

โดยใช้กล้องตรวจจับความร้อน

**Measuring PCB temperature**

Thermal imaging measurements were performed using a thermal video system (TVS-500, from NEC Avio Infrared Technologies Co., Ltd.) that was set up on a tripod looking down on the PCB.

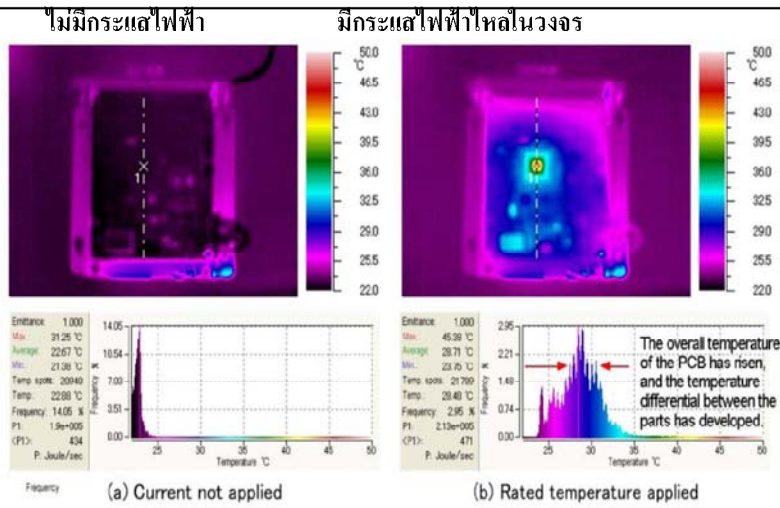
Thermal images were recorded at one-minute intervals from above.



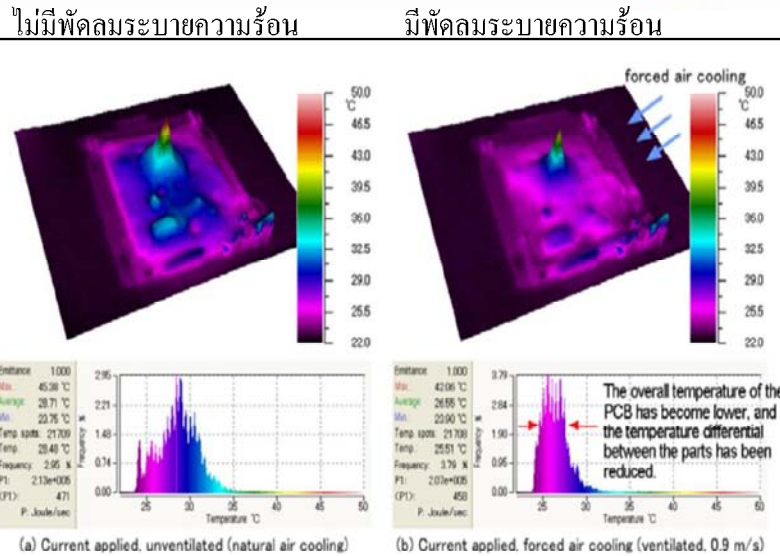
Visible image of measurement PCB

Table 1 Measurement conditions

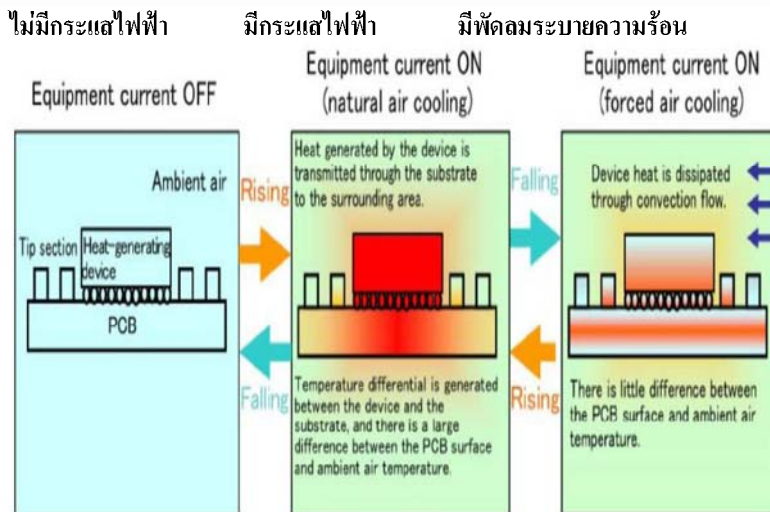
|  |   |
|--|---|
| Measurement substrate                      | Substrate: Glass epoxy substrate<br>Size: 120 x 140 x 1.6 mm  |
| Measurement IC                             | 32-bit RISC processor<br>Power consumption (max.): 0.5 W<br>Package: QFP208 pin   |
| Measurement conditions - 1 (thermal image) | Detection element: two-dimensional uncooled microbolometer<br>Thermal image resolution: 320 x 240 pixels<br>Measurement cycle: 1-min. intervals |
| Measurement conditions - 2 (temp. history) | Detection element: Thermocouple type T (copper/copper-nickel)<br>Measurement cycle: 1-sec. intervals  |



**Fig.1 Thermal image and temperature frequency of mounted PCB (unventilated, ambient temp. 22°C)**



**Fig.2 Thermal image analysis with natural and forced cooling**



**Fig.3 Concept diagram of temperature change from current and cooling**

ตัวอย่างการใช้เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น  
ในระหว่างการขนส่งสินค้า เพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์

หรือจัดการควบคุม วิธีการขนส่ง



Photo 1 The Thermorecorder

92

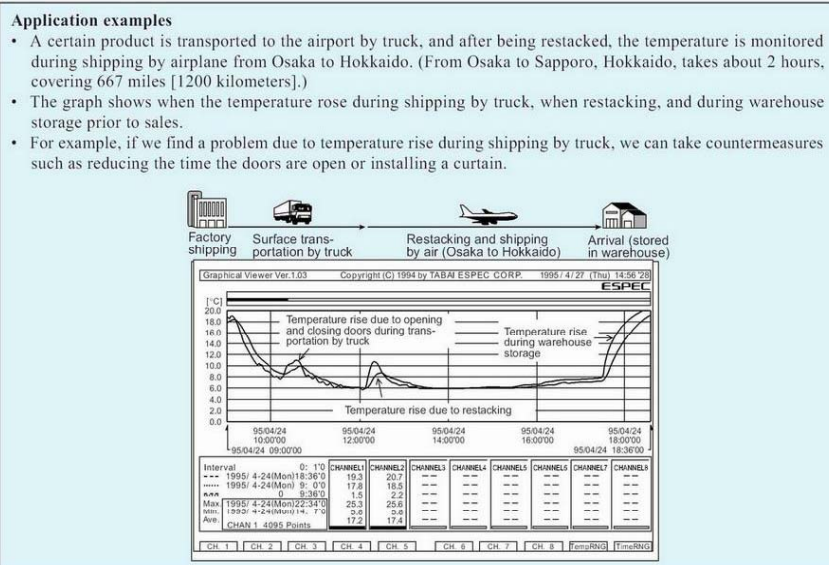


Fig. 1 An example of using the Thermorecorder

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

การศึกษาอุณหภูมิ ความชื้น ในร้านเบเกอรี่ ที่ญี่ปุ่น



Photo 2 Dew condensation on the glass showcase

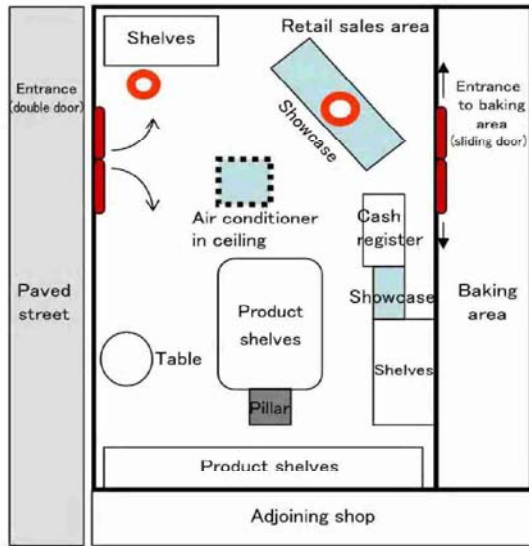


Fig.5 Shop layout (○ Rings indicate temp./humidity measurement points.)

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

มีการปรับปรุงทิศ  
ทางการไหลเวียน  
อากาศภายในร้าน  
ใหม่โดย จัดให้มี  
ทิศทางลมที่ลดการ  
ปะทะโดยตรงจาก  
อากาศนอกร้านเมื่อ  
มีการเปิดประตู

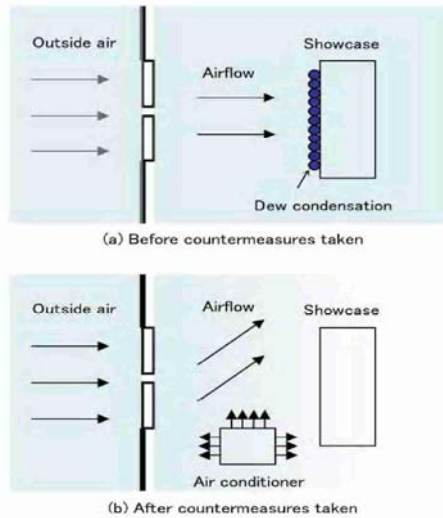


Fig.8 Concept diagram of airflow

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

ผลการศึกษา  
พบว่าสามารถ  
ลดการเกิดไอน้ำ  
เกาะที่ตู้โชว์  
เนื่องจากความ  
ความชื้นลงได้  
10-20%RH

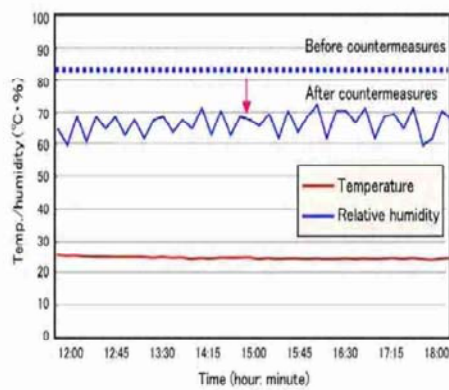


Fig.9 Changes in temperature and humidity following dew condensation countermeasures

Sithiporn Associates Co.,Ltd.





Photo 3 Showcase after dew condensation countermeasures taken

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive maintenance for Chamber / Oven

99

ขอบคุณครับ

ありがとうございます。

Thank You Very Much :-))



100